

Title (en)

METHOD AND DEVICE FOR CLEANING AND DRYING ELECTRONIC PRINTED CIRCUITS.

Title (de)

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR REINIGUNG UND TROCKNUNG VON GEDRUCKTEN ELEKTRONISCHEN SCHALTUNGEN.

Title (fr)

PROCEDE ET DISPOSITIF POUR NETTOYER ET SECHER DES CIRCUITS ELECTRONIQUES IMPRIMES.

Publication

**EP 0240528 A1 19871014 (FR)**

Application

**EP 86905850 A 19860929**

Priority

- FR 8514979 A 19851001
- FR 8613644 A 19860926

Abstract (en)

[origin: WO8702213A1] The invention relates to the cleaning of electronic circuits (6) comprised of electronic components (7, 8, 9), welded according to a known process on to printed circuits carried by a card (10). The injector (1) projects at high pressure a thin liquid curtain (2) which, at its impact on the card (10), is separated into two very thin liquid layers (14 and 15). Said layers pass into the interstices of a few microns which are under the components (7, 8, 9), between those and the card (10). The impurities are expelled from said interstices . Application: removal of waste originating from fabrication and due to the presence of residual impurities under the electronic components (7, 8, 9).

Abstract (fr)

Nettoyage de circuits électroniques (6) constituées par des composants électroniques (7), (8), (9), soudés à la manière connue, sur des circuits imprimés que porte une carte (10). L'injecteur (1) projette sous forte pression un mince rideau liquide (2), qui, à son impact sur la carte (10), se sépare en deux couches liquides très minces (14) et (15). Ces dernières passent dans les interstices de quelques microns situés sous les constituants (7), (8), (9), entre ceux-ci et la carte (10). Les impuretés sont chassées hors de ces interstices. Application: suppression des rebuts provoqués en fabrication par la présence résiduelle d'impuretés sous les constituants électriques (7), (8), (9).

IPC 1-7

**H05K 3/26**; **H05K 3/22**

IPC 8 full level

**B08B 3/02** (2006.01); **H05K 3/22** (2006.01); **H05K 3/26** (2006.01)

CPC (source: EP)

**B08B 3/02** (2013.01); **H05K 3/227** (2013.01); **H05K 3/26** (2013.01); **H05K 2201/10689** (2013.01); **H05K 2203/0746** (2013.01); **H05K 2203/081** (2013.01); **H05K 2203/1509** (2013.01)

Citation (search report)

See references of WO 8702213A1

Designated contracting state (EPC)

DE GB

DOCDB simple family (publication)

**WO 8702213 A1 19870409**; EP 0240528 A1 19871014

DOCDB simple family (application)

**FR 8600334 W 19860929**; EP 86905850 A 19860929